

## CAPITOLATO TECNICO

La presente gara ha per oggetto la produzione di circuiti stampati in Arlon 55 NT multistrato per applicazioni criogeniche. Tali circuiti dovranno pertanto essere esenti da effetti di delaminazione. I circuiti in oggetto sono così composti:

- a) Numero 65 circuiti a massimo 4 layers, come da file Gerber preliminare (\*)
- b) Numero 65 circuiti a massimo 4 layers, come da file Gerber preliminare (\*)

(\*) (TILE&FEB\_PDMdesign\_GERBER.zip )

I PCB di cui sopra potranno subire piccole variazioni rispetto a quanto contenuto nei file allegati, che comunque non aumenteranno il numero di layers e in misura significativa il numero di VIAs. Le dimensioni dei PCB non avranno aumenti in misura superiore al 10%. Una parte dei circuiti al punto a) e b) potranno essere di tipo diverso (ad esempio per quanto riguarda il punto a) potrebbe essere richiesta la produzione di 50 PCB di un certo tipo e altri 15 di tipo lievemente diverso, fermi restando il numero di layer e le dimensioni).

**L'Arlon 55NT necessario alla lavorazione delle schede verrà fornito dall'INFN.**

